

论坛日程
Forum Agenda

8月28日，星期三 Wednesday, 28 August	
上午	<p>10:30-12:30</p> <p>展商论坛1：宽禁带半导体器件—氮化镓及碳化硅 Exhibitor Forum 1: WBG_GaN & SiC 主持人：李祥东，西安电子科技大学，教授 Xidian University A40 展台 Booth A40</p>
	<p>10:30-12:30</p> <p>展商论坛2：功率器件 Exhibitor Forum 2: Power Devices 主持人：王顺利，内蒙古工业大学，教授 Inner Mongolia University of Technology H40 展台 Booth H40</p>
12:30-13:30 午餐 Lunch break	
下午	<p>13:30-16:10</p> <p>展商论坛3：宽禁带半导体器件—碳化硅 Exhibitor Forum 3: WBG_SiC 主持人：茆美琴，合肥工业大学，教授 Hefei University of Technology A40 展台 Booth A40</p>
	<p>13:20-16:30</p> <p>工业论坛1：清洁能源与储能技术 Industry Forum 1: Clean Energy and Energy Storage 主持人：张波，华南理工大学，教授 South China University of Technology H40 展台 Booth H40</p>
8月29日，星期四 Thursday, 29 August	
上午	<p>10:10-12:30</p> <p>展商论坛4：材料与封装 Exhibitor Forum 4: Materials & Packaging 主持人：姜南，无锡能芯检测科技有限公司，总经理 Wuxi Nengxin PowerSemi Lab Co.,Ltd A40 展台 Booth A40</p>
	<p>10:10-12:30</p> <p>展商论坛5：电动汽车 Exhibitor Forum 5: E-Mobility 主持人：康劲松，同济大学，教授 Tongji University H40 展台 Booth H40</p>
12:30-13:30 午餐 Lunch break	
下午	<p>13:30-16:10</p> <p>展商论坛6：电力电子技术应用 Exhibitor Forum 6: Power Electronics Application 主持人：姚刚，上海海事大学，教授 Shanghai Maritime University A40 展台 Booth A40</p>
	<p>13:20-16:30</p> <p>工业论坛2：电动汽车与智能运动 Industry Forum 2: Electric Vehicles and Intelligent Motion 主持人：康劲松，同济大学，教授 Tongji University H40 展台 Booth H40</p>

展商论坛赞助商

Exhibitor Forum Sponsors



展商论坛演讲单位

Exhibitor Forum Speech Companies



工业论坛演讲单位

Industry Forum Speech Companies



*无特定排序，No Specific Order

论坛日程 Forum Agenda

8月28日，星期三 Wednesday, 28 August

		A40展台 Booth A40	H40展台 Booth H40	
上午		展商论坛1：宽禁带半导体器件— 氮化镓及碳化硅 Exhibitor Forum 1: WBG_GaN & SiC 主持人：李祥东，西安电子科技大学，教授 Xidian University	展商论坛2：功率器件 Exhibitor Forum 2: Power Devices 主持人：王顺利，内蒙古工业大学，教授 Inner Mongolia University of Technology	
	10:30-10:50	英飞凌为AI数据中心提供先进的高能效电源解决方案 程文涛，英飞凌科技（中国）有限公司， 大中华区消费、计算与通讯业务市场总监 Infineon Technologies China Co., Ltd.	先进的电动汽车功率单元 孙翌，赛米控丹佛斯 Semikron Danfoss Electronics (Zhuhai) Co., Lt	
	10:50-11:10	ROHM GaN Solution赋能高效能源转换 欧阳荣，罗姆半导体（上海）有限公司，经理 ROHM Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd.	三菱电机最新DIIPM™介绍 王小岭，三菱电机机电（上海）有限公司，经理 Mitsubishi Electric & Electronics (Shanghai) Co., Ltd.	
	11:10-11:30	聚焦硅基氮化镓 展望行业“芯”未来 雷嘉成，上海新微半导体有限公司，研发高级经理 Advanced Micro Semiconductors Co., Ltd.	第七代IGBT模块：助力新一代可再生能源和商用车发展 WK Chong，安森美，大中华区资深现场技术经理 onsemi	
	11:30-11:50	高性能、车规级，赛晶国产1200V SiC MOSFET芯片 Lars Knoll, SwissSEM Technologies AG（赛晶半导体）， SwissSEM Chip R&D（VP）	IGBT模块：针对应用的定制化设计 刘粮恺，成都森未科技有限公司，高级产品经理 Chengdu Semi-Future Technology Co., Ltd.	
	11:50-12:10	The Future of Untethered Robotics: GaN-Powered Solutions for Mobility, AI, and Machine Vision Alex Lidow, CEO, Efficient Power Conversion (EPC)	安世半导体全新650V单管IGBT为工业应用的可靠性赋能 胡兴江，安世半导体，IGBT产品线市场经理 Nexperia	
	12:10-12:30	SiC 新一代产品及其应用 朱魏清，瑶芯微电子科技（上海）有限公司，市场VP Alkaid-semi Technologies（Shanghai）Co.,Ltd	新型功率器件在光伏逆变及储能PCS中的应用 曹帅，江苏宏微科技股份有限公司，应用工程师 MacMic Science & Technology Co., Ltd.	
	12:30-13:30	午餐 Lunch break		
	下午		展商论坛3：宽禁带半导体器件— 碳化硅 Exhibitor Forum 3: WBG_SiC 主持人：茆美琴，合肥工业大学，教授 Hefei University of Technology	工业论坛1：清洁能源与储能技术 Industry Forum 1: Clean Energy and Energy Storage 主持人：张波，华南理工大学，教授 South China University of Technology
		13:30-13:50	以芯创新，碳化硅产品应用创新之路 赵天意，英飞凌科技（中国）有限公司， 工业与基础设施业务 大中华区市场总监 Infineon Technologies China Co., Ltd.	主持人开场 Chair's opening speech
13:50-14:10		适用于新能源应用的2.3kV Si和SiC模块 朱伟杰，富士电机（中国）有限公司，经理 Fuji Electric (China) Co., Ltd	PWM导致高比例电力电子装备电力系统宽频振荡的机理 张波，华南理工大学，教授 South China University of Technology	
14:10-14:30		面向中大功率应用的三菱电机最新SiC功率模块 孙建，三菱电机机电（上海）有限公司，副经理 Mitsubishi Electric & Electronics (Shanghai) Co., Ltd.	基于电流源/电压源混合的高渗透率新能源发电并网变流器控制策略 张兴，合肥工业大学，教授 Hefei University of Technology	
14:30-14:50		EliteSiC M3e：推动全球电气化大趋势的催化剂 Mrinal Das，安森美，能源解决方案事业群资深产品专家 onsemi	电池储能系统精细化管控技术进展 李睿，上海交通大学，教授 Shanghai Jiao Tong University	
14:50-15:10		安世碳化硅 – 超高性能，赋能电气化和绿色节能的美好未来 王骏跃，安世半导体，中国区SiC负责人 Nexperia	功率半导体方案赋能高效可靠光储系统 陈立烽，英飞凌科技（中国）有限公司，高级技术总监 Infineon Technologies China Co., Ltd.	
15:10-15:30		碳化硅模块赋能电驱系统低碳化 赵满员，赛米控丹佛斯，大中华区产品市场部产品经理 Semikron Danfoss Electronics (Zhuhai) Co., Lt	15:30-16:00 氢能源利用中的电力电子装置 郑大鹏，深圳市禾望电气股份有限公司，副总裁 Shenzhen Hopewind Electric Corporation Limited	
15:30-15:50		东芝碳化硅MOS内置SBD 屈兴国，东芝电子元件（上海）有限公司，技术部 副总监 Toshiba Devices & Storage（Shanghai）Co., Ltd.		
15:50-16:10		高功率密度SiC MOSFET技术研究及新能源解决方案 肖鲁民，南京南瑞半导体有限公司，高级市场经理 Nanjing NARI Semiconductor Co., Ltd	16:00-16:30 新型功率模块在储能的应用 叶常生，赛米控丹佛斯，大中华区产品市场部负责人 Semikron Danfoss Electronics (Zhuhai) Co., Lt	

论坛日程 Forum Agenda

8月29日，星期四 Thursday, 29 August

		A40展台 Booth A40	H40展台 Booth H40
上午		展商论坛4：材料与封装 Exhibitor Forum 4: Materials & Packaging 主持人：姜南，无锡能芯检测科技有限公司，总经理 Wuxi Nengxin PowerSemi Lab Co.,Ltd	展商论坛5：电动汽车 Exhibitor Forum 5: E-Mobility 主持人：康劲松，同济大学，教授 Tongji University
	10:10-10:30	Micromax™高热导银胶车规级半导体应用 卢跃东，塞拉尼斯（上海）电子材料有限公司，总经理 Celanese (Shanghai) Electronic Materials Co., Ltd.	适用于飞控的轻量化电控解决方案 顾伟，英飞凌科技（中国）有限公司，汽车业务 大中华区首席工程师 Infineon Technologies China Co., Ltd.
	10:30-10:50	创新型功率半导体贴装材料及应用 胡彦杰，锢泰公司，华东区高级技术经理 Indium Corporation	博世SiC功率MOSFETs及短路介绍 Horvath Manuel，博世（中国）投资有限公司， Power Semiconductors and Modules Engineering Bosch (China) Investment Ltd.
	10:50-11:10	低温烧结纳米银浆产品及其面向汽车应用的封装互连技术 梅云辉，广州汉源新材料股份有限公司，技术专家 Solderwell Advanced Materials Co.,Ltd	HTV150A高温高压DC-LINK电容薄膜的可靠性 周渊，沙特基础工业公司（SABIC），副高级研究员
	11:10-11:30	烧结技术：增强材料性能与生产效率 赵宇，麦德美爱法，高级业务发展经理 MacDermid Alpha Electronics Solutions	ROHM新型SiC模块驱动xEV未来出行 苏勇锦，罗姆半导体（上海）有限公司，高级经理 ROHM Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd.
	11:30-11:50	新一代碳化硅功率器件封装解决方案 董侃，贺利氏电子，功率市场总监 Heraeus Materials Technology Shanghai Ltd	一种创新的车规级三电平模块eMPack 沈剑鸿，赛米控丹佛斯，现场应用工程师 Semikron Danfoss Electronics (Zhuhai) Co., Lt
	11:50-12:10	推动变革：用于电力电子的下一代陶瓷基板 范围，CeramTec GmbH，中国区销售总监	富士车规级IGBT产品介绍 陈磊，富士电机（中国）有限公司，技术支持经理 Fuji Electric (China) Co., Ltd
	12:10-12:30	SiC模块封装用纳米金属烧结技术进展及趋势 贾强，北京清连科技有限公司，董事长/总经理 Beijing QLsemi Technology Co., Ltd	面向工业与新能源设施应用的车规级SiC功率器件 王世平，株洲中车时代半导体有限公司，市场部部长 ZHUZHOU CRRC TIMES SEMICONDUCTOR CO., LTD
	12:30-13:30	午餐 Lunch break	
	下午		展商论坛6：电力电子技术应用 Exhibitor Forum 6: Power Electronics Application 主持人：姚刚，上海海事大学，教授 Shanghai Maritime University
13:30-13:50		SiC MOSFET晶圆级到器件级精准电性能与可靠性测试挑战与解决方案 毛赛君，忱芯科技（上海）有限公司，CEO Unisic	主持人开场 Chair's opening speech
13:50-14:10		应对宽禁带功率半导体动静态参数测试挑战 张纪泽，是德科技（中国）有限公司，功率半导体解决方案规划师 Keysight Technologies (China) Co., Ltd.	新能源汽车产业趋势与供应链技术创新 蔡蔚，哈尔滨理工大学，博导教授/首席科学家 Harbin University of Science and Technology
14:10-14:30		适用于可再生能源发电和储能应用的超紧凑即插即用型门极驱动器解决方案 王皓，Power Integrations Inc.，大功率系统工程师经理	电动汽车应用中的碳化硅器件并联有源均流技术 张军明，浙江大学，教授 Zhejiang University
14:30-14:50		飞镓碳化硅器件在新能源市场的应用 袁建，飞镓半导体（上海）有限公司，产品市场副总监 APS Shanghai Ltd.	14:30-15:00 三菱电机电动汽车用第3代T-PM解决方案 赵利忠，三菱电机机电（上海）有限公司，副经理 Mitsubishi Electric & Electronics (Shanghai) Co., Ltd.
14:50-15:10		西门子Simcenter MicReD在功率器件热阻及功率循环测试的解决方案 王义浩，深圳市贝思科尔软件技术有限公司，高级应用工程师 BasiCAE Technology Limited	15:00-15:30 闭环自学习智能驾驶系统关键技术 黄岩军，同济大学，教授 Tongji University
15:10-15:30		功率模块结温测试方法比较 Andrew Yang，安森美，亚太区资深应用工程师 onsemi	15:30-16:00 机器人智能运动控制的关键技术 陈春杰，中国科学院深圳先进技术研究院，教授 Shenzhen Institute of Advanced Technology Chinese Academy of Science
15:30-15:50		如何为高压电动汽车挑选安全可靠的元器件？ Faith Luo，楼世电子（上海）有限公司，Staff Application Engineer Knowles Precision Devices	16:00-16:30 在中国，为中国：大众中国科技有限公司电子开发战略 张若岚，大众汽车（中国）科技有限公司天津分公司，电子开发部门经理 Volkswagen China Technology Company Tianjin Branch
15:50-16:10		博世SiC赋能未来电动出行——功率模块 冯波，博世（中国）投资有限公司，研发总监 Bosch (China) Investment Ltd.	
16:10-16:30		高功率密度模块及一体化逆变研究 凌欢，浙江翠展微电子股份有限公司，应用开发经理 ZheJiang Grecon Semiconductor Co.,Ltd	